

Vom Halbleiterfertiger zum Innovationspartner

Seit dem 01.01.2016 ist Fujitsu Semiconductor Europe (FSEU) als Fujitsu Electronics Europe (FEEU) aktiv. Geschäftsführer Axel Tripkewitz verrät Näheres über die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

Herr Tripkewitz, seit dem 1. Januar heißt Ihr Unternehmen Fujitsu Electronics (FEEU) Europe. Sie wollen fortan nicht nur für Halbleiter, sondern für ein breiteres Angebot an Elektronik-Lösungen stehen. Wie sieht das neue Geschäftsmodell aus?

Wir sind seit über 30 Jahren auf dem europäischen Elektronikmarkt aktiv, zuletzt als Hersteller unter dem Namen Fujitsu Semiconductor Europe. Unsere Ausrichtung ändert sich mit der Umfirmierung: FEEU ist ein neuer globaler Distributor, der einige Besonderheiten mitbringt.

Was unterscheidet Sie von anderen Distributoren auf dem Markt?

Einige Lösungen in unserem Portfolio stellen wir selbst her und vertreiben diese auch, beispielsweise FRAM (Ferroelectric Random Access Memory). Zudem vertreiben wir Lösungen aus dem Fujitsu-Universum – hierzu gehören heute zum Beispiel PCBs von Fujitsu Interconnect Technologies oder DC/DC Konverter von FDK. Auch Lösungen ehemaliger Fujitsu-Firmen wie Custom SoCs oder Imaging und Graphics-Lösungen von Socionext bieten wir an.

Ein weiteres Standbein, das wir weiter ausbauen werden, sind Lösungen von Drittanbietern. Gallium-Nitrid-(GaN)-Leistungselemente von Transphorm gehören in diese Kategorie und sind heute schon über uns zu beziehen.

Für alle Produkte unserer Linecard gilt ein „Best-in-Class“-Ansatz: Wir haben immer nur die aus unserer Sicht beste Lösung aus einem Bereich im Portfolio – wir bieten

keine Konkurrenzprodukte parallel an. Wir sehen uns zudem als Spezialisten für komplexere Produkte, die wir dank unserer Beratungskompetenz für den optimalen Einsatz in den Applikationen unserer Kunden anpassen können.

Was, wenn ein Kunde doch einmal etwas aus einem anderen Portfolio benötigt?

Wenn unsere Kunden trotzdem auch Standardprodukte benötigen, müssen sie keinen neuen Vendor anlegen. Diese können sie dann ebenfalls über uns beziehen, im Direktvertrieb, über den neu aufgebauten Web-Shop sowie über unsere Distributionspartner.

Außer in Bezug auf Ihr Portfolio – wie wollen Sie sich noch von anderen Elektronik-Distributoren abgrenzen?

Die Kombination aus lokaler Kompetenz und globalen Eigenschaften, gepaart mit hoher technischer Expertise, grenzt uns von den bestehenden Playern ab. Mit Standorten in Langen bei Frankfurt, in München, Mailand, Budapest und Istanbul sind wir nah an unseren europäischen Kunden. Weil wir schon so lange in diesen Märkten aktiv sind, haben wir ein hohes Verständnis für die technologischen Roadmaps unserer Kunden aufgebaut. Mit unserem nun breiteren Portfolio geht ein breiteres Wissen über die technischen Optionen einher, das wir in die Beratung unserer lokalen Kunden einbringen können.

Neben lokaler Expertise haben wir als Fujitsu-Firma einen riesigen Startvorteil, was unsere globalen Fähigkeiten betrifft. Alle Lösungen stellen wir über unsere etablierte, hochleistungsfähige und global aufgestellte Lieferkette bereit, über die wir in der Lage sind, unterschiedlichste Business-Modelle abzubilden. Wir haben den Anspruch, für unsere Kunden ein Gateway zu den besten Lösungen weltweit zu werden. Unser Ziel war es schon immer, passgenaue Lösungen in enger Zusammenarbeit



1967	Begins production of Multilayer PCB at Kawasaki Plant
1972	Moves PCB produktion to Nagano Plant
	Begins production of PCB at Kanuma Plant
1973	Begins production of High-density Multilayer PCB (18-layer)
1983	Opens Akashi Plant for mass production
1985	Begins production of Large-size High-density Multilayer PCB (42-layer)
1988	Begins production of High-multilayer ceramic PCB (62-layer)
1993	Begins production of Multi-chip-module (Thin-film 5-layer)
1994	Obtains ISO 9000 Certification
1995	Begins production of PCB mounting at Vietnam Plant
1996	Begins production of PCB at Vietnam Plant
1997	Obtains ISO 14001 Certification
1999	Begins production of FC-BGA Substrate (GigaModule)
2001	Begins mass production of Organic Multi-chip-module
2002	FUJITSU INTERCONNECT TECHNOLOGIES LIMITED becomes independent company from FUJITSU LIMITED
	Begins PCB business Production (Consolidated production at Nagano Plant and Vietnam Plant Sales) Based in Kawasaki, Kansai, USA, and Taiwan
2003	Announces joint development of Printed Wiring Board with a new structure in partnership with Matsushita Electric Components Co., Limited
2003	Begins production of next-generation probe cards
2004	Develops world's first Multi-layer PCB capable of 5Gbps transmission and 4000 pin mounting
2005	Begins production of coreless FC-BGA Substrates (GigaModule)
2006	Improves production capacity of FC-BGA Substrates (GigaModule)
	Expands types of next-generation probe cards by commercializing first-generation BBC technology
2007	Improves production capacity of high layer count, high aspect substrates
2011	Begins production of the „K computer“ substrate
2012	Receives Japan Institute of Electronics Packaging's 2012 Technology Award, jointly with Fujitsu Advanced Technology Limited, for the development of the substrate for the K computer
2013	Absorbes SHIN-ETSU FUJITSU LIMITED

Quelle: Fujitsu Electronics Europe

Tabelle: Historie von FICT. Sehen Sie hierzu auch folgenden Beitrag auf der rechten Seite.




	Software	Application	
CAD	Fujitsu CAD *	High-End Product, etc.	
	CR-5000/BD	Consumer Product, etc.	
	Allegro/APD	Package Substrate, Tester, etc.	
	CADVANCE	Semiconductor Tester, etc.	
SIM	Signal Adviser *	Design Condition Analysis	
	SIGAL-SI *	Transmission wave Analysis	
	SIGAL-PI *	Power Noise Analysis	
	HSPICE	Analog Analysis	
	MW-STUDIO	Three Dimensional	
	DEMITASNX	Plane Resonance Analysis	
CAM	In-CAM	DFM Analysis	
	PC-AutoCAM	Data Edit of Gerber	

Bild: Fujitsu Electronics Europe

Verfügbare Systeme: Auch wie Simulationen sowie Design- oder Laborservices sind im Angebot.

mit unseren Kunden zu entwickeln. Hier ist über die Jahre viel Vertrauen aufgebaut worden, das wir auch weiterhin rechtfertigen wollen, um eine Win-Win-Win Situation zu erzielen – größtmögliche Wertschöpfung für alle Partner durch das Schaffen von Synergien.

Wofür steht die neue Marke Fujitsu Electronics Europe?

Wir haben uns den Claim „Accelerating Global Innovation“ als Vision auf die Fahnen geschrieben. Konkret bedeutet das, dass wir Innovationshemmnisse abbauen und den technischen Fortschritt dadurch beschleunigen wollen. Innovationshemmnisse sind beispielsweise eine mangelnde Markttransparenz in Bezug auf die besten Lösungen oder Abstimmungsschwierigkeiten bei Verträgen.

Wir bauen diese Hemmnisse ab, indem wir unsere Kunden schneller zu besseren Lösungen lotsen, technische Beratung rund um deren optimalen Einsatz bieten und die Lösungen mit höchster Planungssicherheit für den Kunden liefern. Wir tun dies auch, indem wir immer weiter nach hervorragenden Lösungen Ausschau halten, die das Potenzial haben, die Roadmaps unserer Kunden weiter zu verbessern und indem wir unsere interkulturelle Kompetenz einbringen, um Verhandlungen zu beschleunigen.

Weil wir bei unseren Zulieferern auf Klasse und nicht auf Masse setzen, haben wir die Möglichkeit, den aktuellen und zukünftigen Bedarf unserer Kunden an diese zu kommunizieren. So können wir mit den Zulieferern zusammen frühzeitig Lösungen auf den Weg bringen, die den identifizierten Kundenbedarf in den jeweiligen Marktsegmenten bestmöglich abdecken. Auch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lieferanten beschleunigt Innovation. Auch wollen wir in Zukunft verstärkt Synergien zwischen Lieferantenlösungen schaffen und auch so Mehrwert für Kunden bieten.

Was ist Ihre Vision für Ihr Unternehmen und den Markt? Welche Erwartungen haben Sie an die Zukunft?

Wir sind der Meinung, dass der Markt reif ist für einen strategischen Distributionspartner und Treiber von Fortschritt und freuen uns sehr auf eine innovationsfreundliche Zukunft zusammen mit unseren Kunden und Lieferanten! // SG

Fujitsu Electronics Europe (FEEU)
+49(0)6103 690461